



刘健

求职意向：硬件开发工程师

学历：硕士

出生年月：1993.12

电话：17337688770

邮箱：1377337802@qq.com

教育背景

安阳工学院（本科）	电子信息工程	2014.09-2018.06
北方工业大学（硕士）	电力电子与电力传动	2018.09-2021.09

工作经历

① 小米科技公司（武汉） 硬件工程师 2021.10 – 2026.06

负责项目：冰空洗主板显板硬件开发全流程。

1. 行业洞察能力：完成 6 款竞品板卡电路设计对标，性能对标，BOM 成本对标；
2. 设计能力：负责 10 款冰箱主板， 4 款显板开发，主导硬件方案，电路原理图及 PCB 设计与评审，BOM 输出；
3. 测试能力：负责单板电源，负载软件逻辑验证，变频器电性能，环境可靠性及整机 EMC 测试整改工作，输出测试整改报告；
4. DFMA 能力：负责 PCBA 试产过程中生产工艺和整机装配过程中的制程问题优化；
5. 故障分析能力：主导售后板卡问题分析及推动质量提升，故障率控制水平行业领先；
6. 平台规划能力：参与 3 个平台化方案设计，提高电路标准化率，降本数千万元；
7. 创新能力：发表专利 39 篇，实用新型 21 篇（已授权），发明 18 篇（授权 3 篇，其它实质审查阶段）；制定企业标准 5 篇（主板+显板+出海产品设计测试标准）；
8. 模块协同能力：与项目，结构，品质，ID 等协作，保证项目保质保量的按时完成。

研究生项目经历

1. 800W/CBCT 口腔成像设备/PFC+推挽+逆变+倍压电路+ATmega16AU；
2. 220W/四管 Buck-Boost 光伏均衡器/PID+MPPT+DSP28035 最小系统+数字补偿器；
3. 300W/图腾柱无桥 PFC/TCM PFC+ZCD+DSP28035+信号调理电路+环路补偿。

专业技能

1. 熟练使用实验室常用仪器，如万用表、信号发生器、频谱仪、LCR，示波器等仪器；
2. 扎实半导体器件知识，熟悉二极管，三极管，MOSFET，IGBT，OPA 等工艺流程及电气特性；

3. 掌握多种开关电源拓扑（Buck/Boost/Flyback/PFC/LLC...）的原理，环路补偿，控制模式；
4. 仿真软件：熟悉 Ltspice、Psim、Plecs、Mathcad，擅长 Allegro、AD、MATLAB 等软件；
5. 办公软件：精通 Office 系列软件深层功能，能够熟练制作各种文档、报告、PPT 等。

核心优势

1. 技术创新与攻坚，见证并参与了小米大家电从 ODM 转 OEM 核心技术自研过程，构建差异化的竞争优势；
2. 对产品风险把控能力，在职 5 年，主板和显示板板卡出货量 1000 多万套，无市场批量事故，可靠性得到市场充分验证；
3. 成本控制与管理，擅长源头成本优化，拥有多个单板降本案例；精通 IPD 及 ODM/OEM 流程，具备复杂项目管理与平台搭建能力。

自我评价

诚实负责，积极乐观，自驱力强，爱好运动美食。